

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p>申港证券—曲一平、戴一爽（2021.12.8，时间：11：00-12：00，现场调研）</p> <p>融通基金—杨若愚、樊鑫 理成资产—谢定禾、陶然 中银基金—袁哲航</p> <p>中泰证券—朱佳妮（2021.12.9，时间：10：00-11：00，电话会议）</p> <p>东北证券资管—支嘉文、唐瑜 中泰证券自营—刘博宇、邓明星 农银汇理—姚一鸣 海通自营—尤成其 东吴资管—郑斌 富国基金—宁丰 银华基金—冯帆 万联证券自营—杨吉春 海通期货资管—周水松 太平养老—邱培宇 首创证券自营—王桐桐 恒泰证券自营—张浩楠、袁利梅 申万证券资管—傅晶晶 融通基金—朱浩然 川财证券自营—齐浩淳 宁银理财—韦婉 粤开证券自营—张亚光 瑞泰人寿—王岚 长江期货资管—苏晶 渤海证券自营—任黛云 中信建投自营—冯秀娟 万家基金—周实 西部利得基金—梁晓明</p> <p>中银证券—王达婷（2021.12.9，时间：16：00-17：00，电话</p>

会议)

景林资产—孙玮
淳厚基金—吴若宗
鹏华基金—王威
光证资管—李行杰
中信建投—徐博
海富通基金—刘海啸
磐厚资产—钱监亮
光大保德基金金—丑凯亮
华宸未来基金—李柏汗
天惠投资—金骁
民生通惠资管—肖艳华
景泰利丰—吕伟志
太平资产管理有限公司—赵洋
华安财保—李阳
长见投资—刘志敏、唐祝益
华安财保资产管理有限责任公司—李亚鑫
中银三星人寿—林相洁
工银瑞信—周颖辉
国泰基金管理有限公司—刘波
泰信基金—吴秉韬
东方阿尔法—梁少文
陕西星河投资管理有限公司—谢国强
中意资产—臧怡
长盛基金管理有限公司—钱文礼
国泰基金管理有限公司—张阳
金鹰基金—田啸
中银基金—王寒
国寿安保—张标
长城人寿保险—胡纪元
长信基金—李宇
中信资管—程伟庆
银河基金—神玉飞
泰康资产管理有限责任公司—薛小波
九泰基金—宋伟
工银瑞信基金管理有限公司—石正同
磐厚资产—钱监亮
上海从容投资管理有限公司—茅珈恺
星石投资—杨英
中海基金—王含嫣
民生加银基金—王凤娟
浦银安盛基金理有限公司—朱胜波
上海潼骁投资发展中心—王喆
华宝基金—陈龙
南京证券—章琪
前海开源—田维
华夏久盈—桑永亮

	汇华理财有限公司—张运昌 新华资产—耿金文 西部自营—杜威
会议时间	2021年12月8日 11:00—12:00（申港证券） 2021年10月9日 10:00—11:00（中泰证券） 2021年12月9日 16:00—17:00（中银证券）
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生，公司董秘办主任、 证券事务代表：沈志鹏先生，公司证券事务与投资者关系管理 专员：秦境凤女士、虞晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2021年三季度报营收情况。</p> <p>各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。</p> <p>公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。目前，公司的晶闸管系列产品、二极管及防护系列等产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体；公司的MOSFET系列产品采用Fabless+封测的业务模式。</p> <p>公司2021年前三季度，在客户端的支持与关心下，在全体员工的共同努力下，实现营业收入134,612.5万元，较上年同期增长94.75%；实现利润总额45,181.8万元，较上年同期增长了97.74%；归属于上市公司股东的净利润为38,893.7万</p>

元，较上年同期增长了100.80%。其中，晶闸管（芯片+器件）营业收入为48,467.6万元，占公司前三季度营业收入的36.01%，营业成本为20,711.5万元，毛利率为57.27%；防护器件（芯片+器件）营业收入为45,410.6万元，占公司前三季度营业收入的33.73%，营业成本为21,277.8万元，毛利率为53.14%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为37,650.6万元，占公司前三季度营业收入的27.97%，营业成本为26,824.7万元，毛利率为28.75%。其中，公司2021年第三季度实现营业收入49,432.4万元，较上年同期增长74.25%；实现利润总额16,502.2万元，较上年同期增长了81.60%；归属于上市公司股东的净利润为14,938.4万元，较上年同期增长了94.11%。其中，晶闸管（芯片+器件）营业收入为15,102.1万元，占公司第三季度营业收入的30.55%，营业成本为6,745.6万元，毛利率为55.33%；防护器件（芯片+器件）营业收入16,696.1万元，占公司第三季度营业收入的33.78%，营业成本为7,873.5万元，毛利率为52.84%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为16,440.8万元，占公司第三季度营业收入的33.26%，营业成本为10,869.8万元，毛利率为33.89%。

二、主要交流问题

1、公司今年营收增速为什么会大幅提高？

答：根据捷捷微电2021年三季报数据来看，公司今年营收增速大幅提高的主要原因有：外部因素：1. 国家对半导体行业持续的支持和关注；2. 受新冠疫情影响，国外厂商产能不足或交期拉长，国产替代进口程度不断提高；3. 公司下游领域需求旺盛等。内部因素：1. IPO项目处在较好发挥边际效应的阶段；2. 定增项目增厚存量业务的产能利用率正稳步提升；3. 效率高，我们通过工艺改进、优化流程、提升管理水平使芯片生产周期大幅缩短；4. 优势产品的竞争能力，比如我们的晶闸管系列产品是这个细分产品领域的龙头，今年经由工信部已确定授予国家级专精特新“小巨人”企业称号，以及

我们的防护器件，同样也具有国内领先的竞争力；5. 公司芯片研发能力和定制化设计能力。

公司立足于我国市场的实际情况，根据终端产品需求多样化和升级换代快的特点，依托于芯片研发设计技术优势，目前已经研发并生产多种型号和规格的标准产品，并通过对客户需求的评估生产个性化产品。公司为客户定制产品，需要结合生产工艺的调整和关键技术的协调匹配，是公司芯片研发能力的重要体现，也是公司差异化发展的重要标志。至于未来，我们要脚踏实地深耕于功率半导体产业，保持功率半导体IDM核心竞争力优势以及MOS等业务的协同能力等。谢谢！

2、公司目前主要产品晶闸管、防护器件、MOSFET产能分别是多少？预计今年和未来各项业务增速多少？

答：晶闸管和防护器件业务，目前我们主要依托4寸Fab，2020年我们的4寸晶圆产能利用率约340万片，今年预计能达到约500万片。公司MOSFET芯片是由无锡和上海团队设计，委外流片，其中芯片（8英寸为主）全部委外流片，封测方面目前委外代工为主、自封为辅，目前的自封率约30%左右。公司今年整体的销售情况预计在16-18亿之间，增速较高，符合公司的预期。根据公司整体布局规划，明年各项业务年增长率目标为：晶闸管增速10%、防护器件增速30%、MOSFET目标翻一翻，具体还要基于公司可转债等项目建设与推进等。做好当下，即是未来，请各位投资者以公司相关公告为准。谢谢！

3、请问公司6英寸项目的工艺及产品有哪些？达产后预计产量是多少？

答：由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建的“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目，计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，继续服务于公司晶闸管及二极管等业务。该项目除了可以扩大现有防护器件

的产能，由于产品的更新迭代，我们还会做一些更高端的二极管，二期也会做一些IGBT小信号的模块。主要产品为快恢复二极管芯片及器件，IGBT模块配套用高电压大通流整流芯片，低电容、低残压等保护器件芯片及器件，中高电压功率集成芯片，平面可控硅芯片及其他芯片产品等。该项目资金来源为捷捷半导体有限公司自有资金，总投资5.1亿元人民币。目前该项目还未动工，项目计划明年开工建设，达产后预计可形成6英寸晶圆100万片/年及100亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力。谢谢！

4、可转债募投项目：车规级封测项目预计何时投产？预计每年能够完成多少产能的封测？

答：功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品以及60kkWCSP电源器件产品的生产能力。项目达产后预计形成20亿的销售规模。目前进展：采购了部分设备，环评已经有了，正在能评等手续办理中，基础设施及配套计划明年开建。谢谢！

5、公司无锡和上海MOSFET产品业务的情况？

答：公司在2017年引进了无锡MOS团队，主要是做TRENCH MOSFET，产品有高压VDMOS、中压VDMOS及低压VDMOS，TRENCH MOSFET主要用于开关电源、照明、高能效家电、工业、通讯等领域；2019年引进了上海MOS团队，该创始团队由来自业界国际知名半导体公司的核心研发和管理人员组成，主要做的是SGT MOSFET，其主要应用汽车电子、消费、家电、工业、通讯等。公司MOSFET的客户与公司现有下游客户有部分重叠，但推广新产品一般会先从交叉客户开始，从少量的试样慢慢切入，

具体应用要比晶闸管业务更广，在2020年公司无锡团队完成了2亿的销售。今年无锡与上海两个MOSFET团队的总营收目标是4亿，其中今年上海临港的MOSFET团队营收目标为1亿。今年公司MOSFET团队有望超额完成目标。谢谢！

6、公司目前MOSFET毛利较低的原因是否是Fabless模式造成？

答：是的。公司MOSFET业务采用的是Fabless+封测模式，MOSFET芯片是由公司无锡和上海团队设计，委外流片，其中芯片（8英寸为主）全部委外流片，封测方面目前委外代工为主、自封为辅。6英寸主要通过杭州立昂微和四川广义等，8英寸是中芯集成等，12英寸是广州粤芯等。器件封装，我们目前自封30%，还有70%也是委外，检测以我们自己为主。MOSFET业务Fabless模式，在这种情形下，晶圆厂和封测厂的产能供应保障存在不确定性，特别是在近几年半导体需求大涨和产能紧张的形势下，公司面临一定程度的原材料供应短缺、外协加工的稳定性和成本上升的风险，业务的可控性与产品交期等受一定影响，包括MOS系列产品毛利率相对来说要低一点等。谢谢！

7、此次可转债募投项目用于MOSFET封装测试，预计会提高MOSFET毛利率至多少？

目前，公司MOSFET业务占前三季度营业收入的比例为28%左右，公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”是配套无锡和上海MOSFET团队，预计明年一季度末完成基础设施及配套等建设，计划明年二季度末或第三季度开始试生产。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等，再加上此次可转债募投项目（功率半导体“车规级”封测产业化项目）用于MOSFET封装测试，当MOSFET的IDM程度越来越高，在未来，毛利率会有一些的提升空间。谢谢！

8、公司下一步是否有生产IGBT产品的计划？

答：公司董事会于2021年11月1日已审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》，同意使用自有资金900万元，投资设立控股子公司江苏易矽科技有限公司（Fabless模式），公司拟投资经营IGBT等新型功率器件产业化项目，目前工作正在积极推进中。该团队有比较好的产业基础和产业背景，基于产业视角，开始应该会做一些通用的产品试试市场，根据项目产业化进程与实际情况还会加大投资。另外，“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”建设项目除了扩大防护器件的产能，由于产品的更新迭代，我们还会做一些更高端的二极管，二期的话也会做一些IGBT小信号的模块。谢谢！

9、贵司下游领域主要应用及占比、代表性客户有哪些？

答：公司下游客户多且分散，应用领域广泛。根据2020年统计的数据，按照产品的应用领域的不同大致分为以下类别：低压电器（16%）、白色家电14%）、小家电（14%）、安防（13%）、通讯（9%）电动工具（8%）、照明（8%）、汽车电子（5%）、电力仪表（5%）、电力模块（4%）、其他（4%），2021年最新数据会在明年重新统计。

公司的下游客户众多，分布广泛，目前下游客户情况：低压电器领域主要有正泰、德力西等；家用电器领域主要有海信、美的等；防护应用领域主要有飞利浦照明、大华股份、威胜集团等；电动工具领域主要有得伟、天宁等；无功补偿、电子电力模块以及摩配领域也有众多优质客户。此外，由于公司的下游应用领域丰富，产品涉及行业广泛，各季度的市场整体需求相对平衡，产品生产和销售受季节性影响相对较小。谢谢！

10、贵公司产品在智能电网应用领域中占比多少，在新能源汽车电子发展方面如何布局？

	<p>答：公司在新能源汽车方面，有部分TVS产品用于充电桩上，主要是提供安全保护。公司正积极布局和丰富汽车电子领域的产品，随着不同终端市场对功率器件的可靠性要求越益重视，特别是国家「十四五」规划及全球对环保减碳排放的硬性要求；捷捷微电聚焦新能源汽车和智能电网等应用，推出车规级 SGT MOSFET 器件。这次捷捷微电推出的十三款车规级功率 MOSFET，严格遵循 IATF 16949 品质管理体系及 AEC-Q101 可靠性验证标准，部分产品已在新能源车上实现车用。目前公司在汽车电子领域的产品销售占比还不是很高，未来是公司努力提升产品占比的下游主要领域之一。谢谢！</p> <p style="text-align: center;">11. 公司12月2日与中芯集成签订战略合作框架协议，是否MOSFET量产提供支持？</p> <p>答：公司与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签订战略合作框架协议，是根据公司战略规划和经营发展需要。捷捷微电将视中芯集成为SGT, SJ, IGBT芯片及模块工艺研发、8英寸晶圆模组制造的重要战略合作伙伴，寻求在SGT, SJ, IGBT芯片及模组领域的长期合作。中芯集成将全力支持捷捷微电的SGT, SJ, IGBT芯片及模块工艺研发，提供长期、稳定、优质的晶圆代工服务，并在工程上相互支持。为增强企业可持续发展能力，提升企业的产品竞争力，公司与中芯集成本着优势互补、共同发展的原则，在中低压 SGT MOSFET、高压 IGBT 与 SJ MOSFET 晶圆及 IPM、PM 等封装领域展开全面战略合作，有利于公司积极推进产品化进程，对公司未来的经营业绩产生积极作用。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021-12-10